

記事掲載

半導体産業新聞 2013年11月27日号

WLP用IJ開発

高効率塗布を実現

と記
テラプローブと
石井表

(株)テラプローブ(横浜市港北区)と(株)石井表記(広島県福山市)は、WLP(ウエハーレベルパッケージ)とバンブ向けに、業界初となる厚膜絶縁塗布材料(ポリイミド)をインクジェット(IJ)方式で塗布するIJコーターを共同開発した。



今後WLPの量産品にIJコーターを適用する(写真)・テラプローブ青梅工場のWLP生産ライン

従来、WLPやバンブ製造工程における絶縁膜塗布工程はスピンコートでの塗布が主流であった。しかし、材料の使用効率が悪いほか、裏面の洗浄工程が必要であるなど課題も多かった。また、厚膜塗布が難しいことも難点の1つであった。今回、共同開発したIJコーターは、対象ウエハ

に超微小化した絶縁材料を直接吹きかけることにより、同じ材料で膜厚を容易に変更することを可能とした。さらに、従来のスピンコートでは不可欠な洗浄工程も不要となり、高い生産性を実現している。

テラプローブでは、石井表記と共同開発したIJコーターをWLPの生産を手がける青梅工場(東京都)に導入済み。現在、条件出しなどを進めており、2014年からの量産品の生産に適用する予定。